

弘塑科技股份有限公司

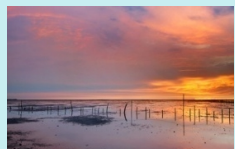
Grand Plastic Technology Corporation

弘塑科技104年度法人說明會

2015.04.29



Agenda



GPT Company Profile by 張鴻泰董事長



Market & Sales Trend by 石本立副總經理



Technology & Products Trend by 吳欣賢副總經理

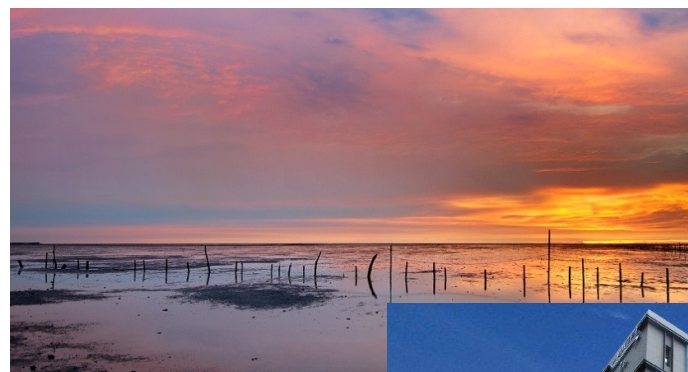
Company Profile

Presented by Hoton Chang

張鴻泰 董事長/總經理

Company Profile

- **Founded : May, 1993**
- **Headquarter : 新竹香山/ Taiwan**
- **Employee : 175**
- **Capital : US\$8.2M (NT\$248M)**
(Jan.'13合併“ChemLeader Corp.(添鴻)”)
- **IPO : 2011/1/17**
- **ISO 9001 : 2000 Certified**
- **SEMI-S2 0310 Certified**
- **Factory**
 - **Manufacturing Clean Room**
 - **Research Lab.**



弘塑21年穩定並持續成長

1993

- 弘塑科技有限公司成立

2000

- 開發第一套300mm全自動濕式晶圓設備

2011

- 正式掛牌上櫃

2012

- 公司遷址至香山新廠 **擴充產能**

2013

- 收購添鴻科技

2014

- Tools + Chemical 持續發展中

弘塑處在的市場環境

- Ø 全世界五大高階(WLCSP)後段封裝廠都以台灣作為主要生產基地： ASE, Amkor, SPIL, tsmc, SCT.
- Ø WLCSP是持續成長的市場
- Ø 各廠家對高階封裝之布局：
Cu-Pillar, InFO-WLP, Fan-out. GPTC都已參與其中.....

弘塑的Strength及核心競爭力

- Ø 累積500套以上之 Field installed 經驗
- Ø 在地廠家：與客戶已建立長期的信賴感並能提供即時的必要支援
- Ø Total solution wet process provider :
Tools + Chemical
- Ø 擅長異質整合（Heterogenous）：客製化

弘塑後續對新需求的因應對策—(1)

Ø 參與客戶先進製程之開發：

1 建立優勢 → 尋求機會 → 達到成效

Ø 同心圓擴散思維：

1. 核心市場：高階封裝
2. 友善市場：2.5D / 3D 封裝及能發揮弘塑核心能力相關的製程設備
3. 鄰近市場：特殊封裝（穿戴式裝置，Biomedical）
4. 大眾市場：LED、GaAs

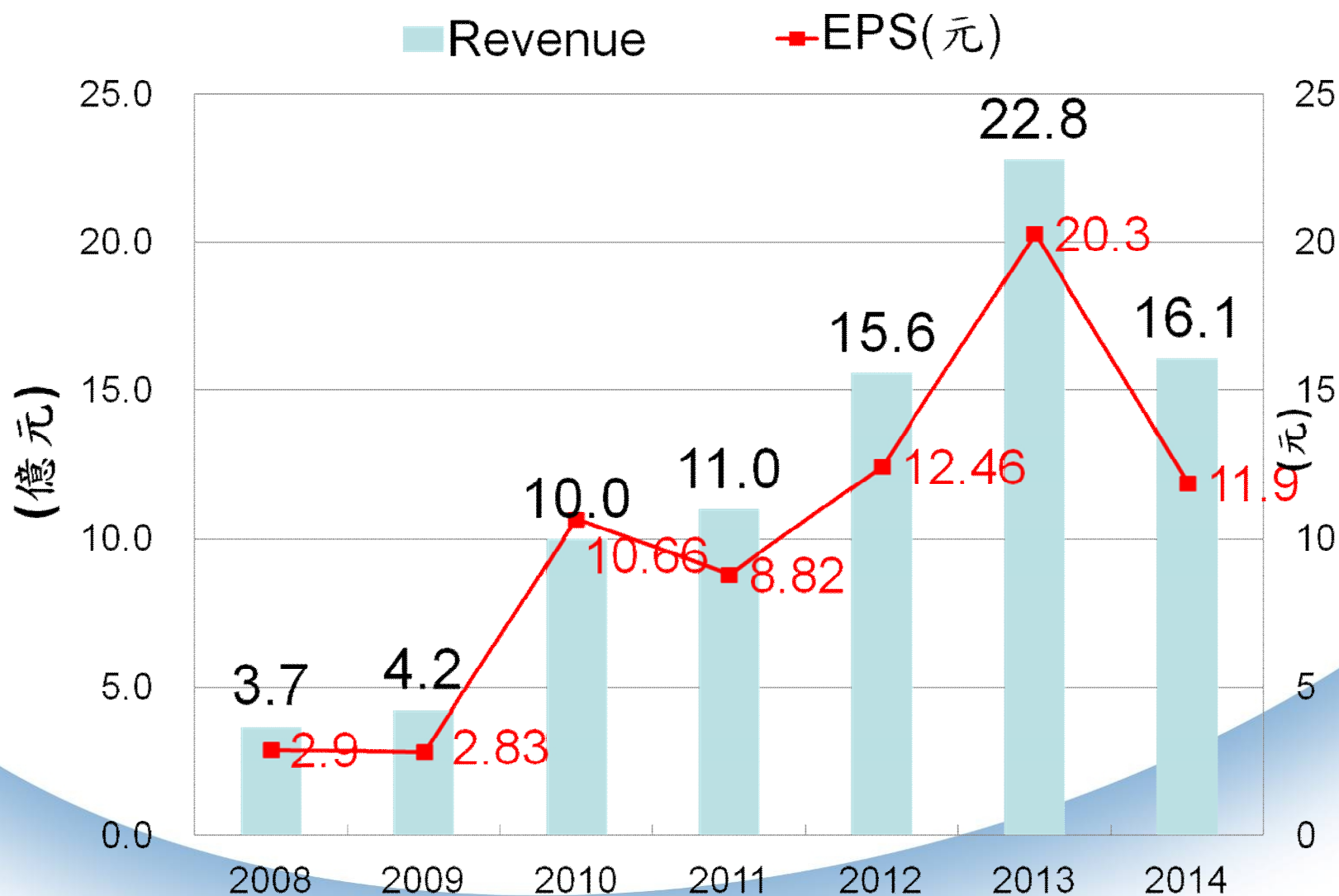
弘塑後續對新需求的因應對策—(2)

- Ø 深耕製程經驗的養成
- Ø 尋求與國外先進大廠策略聯盟跨入新領域
- Ø 增加研發費用及開發

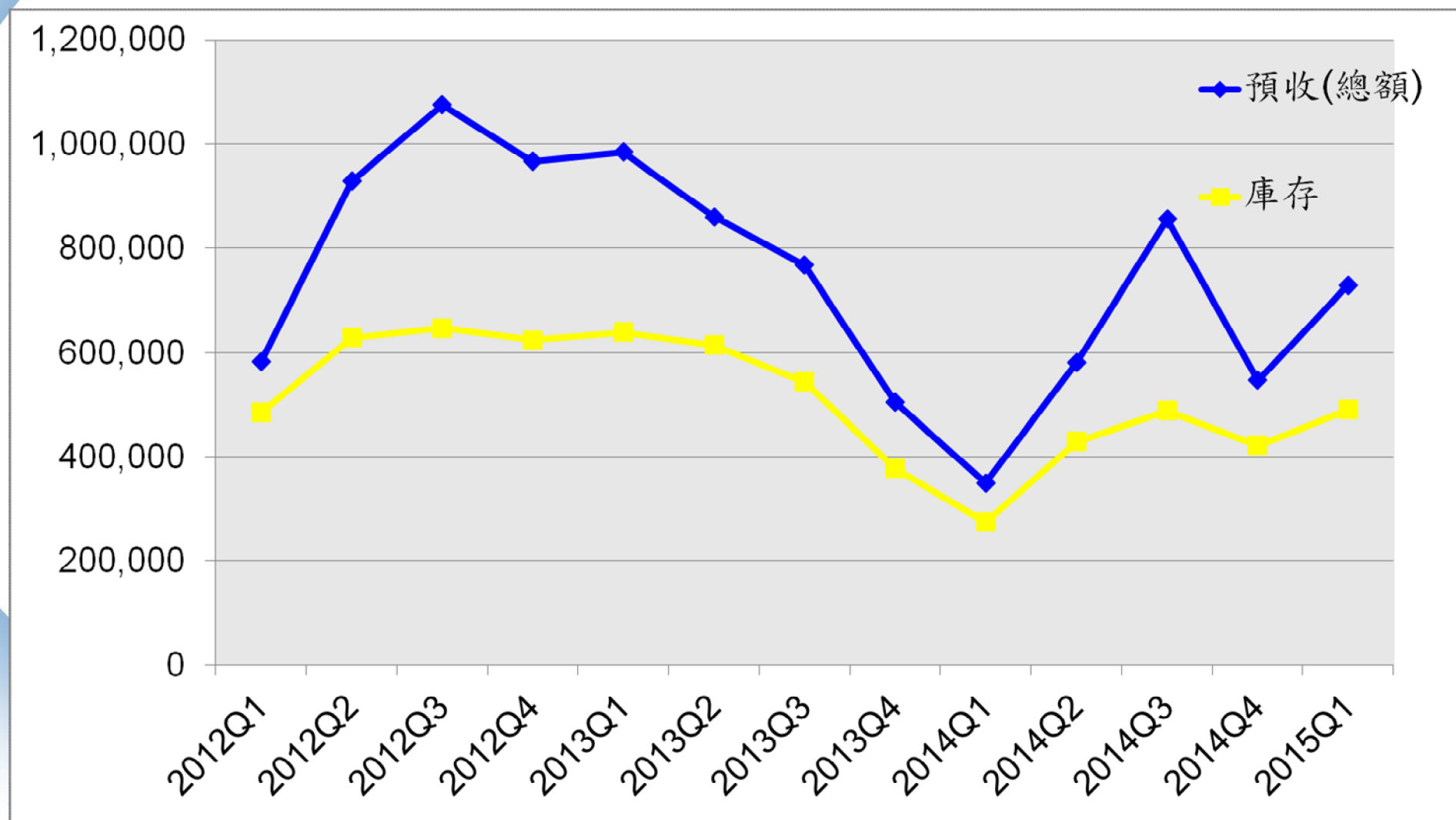
High productive platform

- Ø 加強自行開發之核心軟體技術

弘塑近年來Revenue vs. EPS之比較



弘塑近年來預收、庫存比較



Sales & Market Trend

Presented by Kevin Shih

石本立 業務/客服中心 副總經理

Agenda

1. 市場驅動力及產業變化
2. 銷售分析
3. 成長策略

Agenda

1. 市場驅動力及產業變化
2. 銷售分析
3. 成長策略

Advanced Geometries Bring Demand of Advanced Packaging



Exhibit 19

Industry Capacity Estimates by Technology Node

(8" K wafers)	2010	2011E	2012E
<32nm	810	1,357	3,914
33nm to 45nm	3,191	4,975	5,838
46nm to 65nm	3,632	4,764	5,157
66nm to 90nm			2
0.10u to 0.13u			2
0.14u to 0.18u			8
0.19u to 0.25u			7
0.26u to 0.35u			2
0.36u to 0.5u			3
Total	7,633	11,096	14,909

e = Morgan Stanley Research estimates Source: Company data, Morgan Stanley Research

<65nm,
in K pcs wafers by foundry

2010 2011 2012
7,633 11,096 14,909

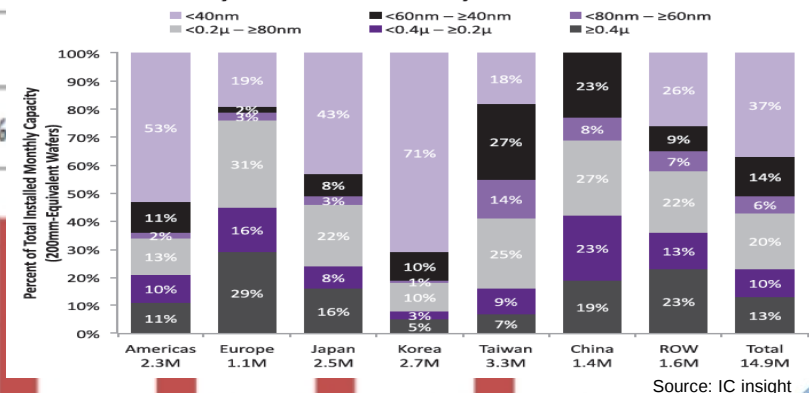
Flip-chip bumping wafer forecast*

by bumping metallurgy (12"eq wafers)

*3D μ -bumping included

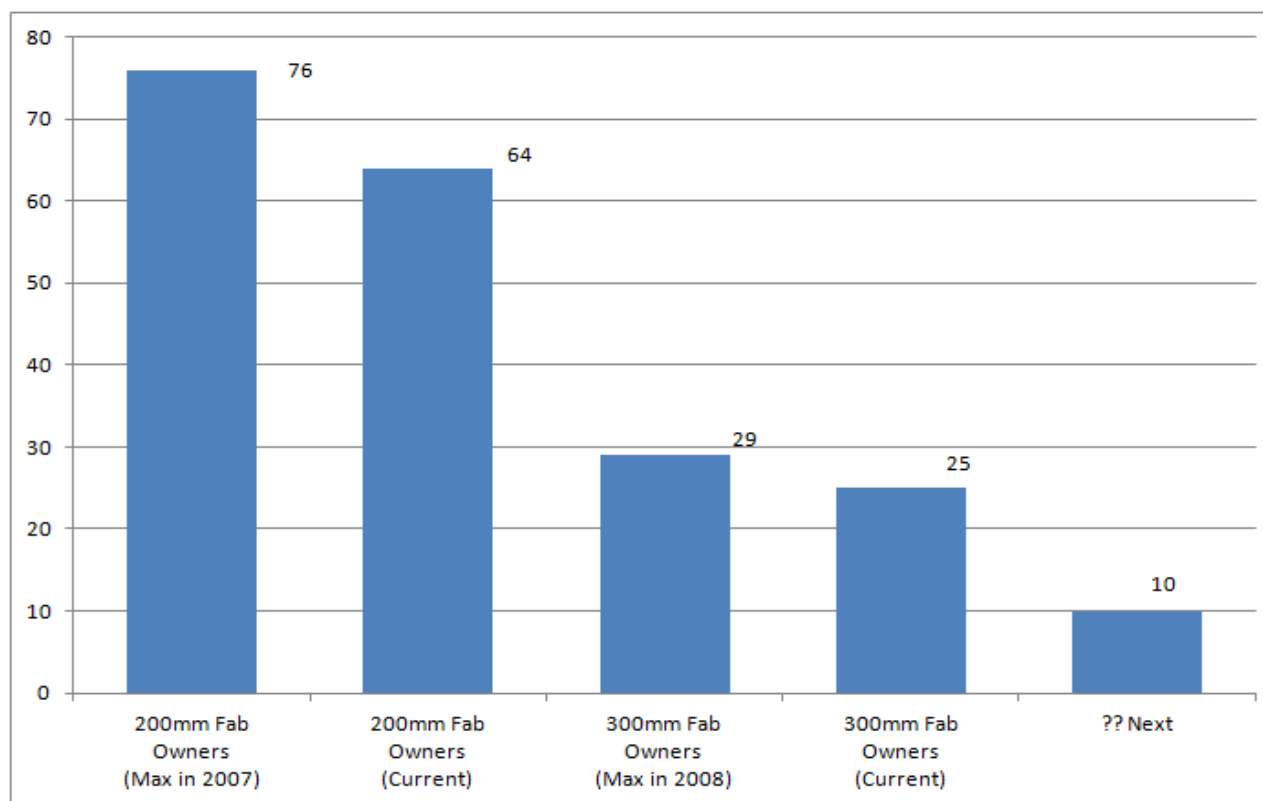
2018 Flip-Chip CAGR = 19%

Installed Monthly Capacity for Each Geographic Region by Minimum Geometry as of Dec-2013



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	CAGR
Cu Pillar	3,114,026	3,711,801	4,608,787	6,350,498	9,309,138	12,498,257	16,677,455	22,960,318	31,515,814	35%
Lead Free Solder	840,621	1,177,525	1,866,335	2,909,256	4,028,828	4,876,255	5,186,103	5,257,127	5,388,522	26%
Sn/Pb Eutectic Solder	3,552,516	3,491,320	3,097,417	2,337,994	1,452,636	805,736	779,035	763,793	762,789	-17%
Gold Stud + Plated	3,136,367	3,151,043	3,270,393	3,354,156	3,479,690	3,657,655	3,852,018	4,081,027	4,312,258	4%
Total	10,643,530	11,531,690	12,842,932	14,951,903	18,270,292	21,837,902	26,494,612	33,062,266	41,979,383	19%

Number of Companies with FAB is Dwindling



Tool vendors are facing same “consolidation” shift....

濕式設備商市場變化

原始公司		合併公司	再合併公司
7	1998	SSES (日本)	
	2006	Akrion (美國)	
SEZ (奧地利)	2008	Lam (美國)	
Semitool (美國)	2009	AMAT (美國)	
SSEC (美國)	2011	黑石控股(美國)	2014 Veeco (美國)
TEL (日本)	2013	AMAT (美國)	
Apprecia (日本)	2013	Tazmo (日本)	

Agenda

1. 市場驅動力及產業變化

2. 銷售分析

1) 營收分析

2) 接單分析

3. 成長策略

Agenda

1. 市場驅動力及產業變化

2. 銷售分析

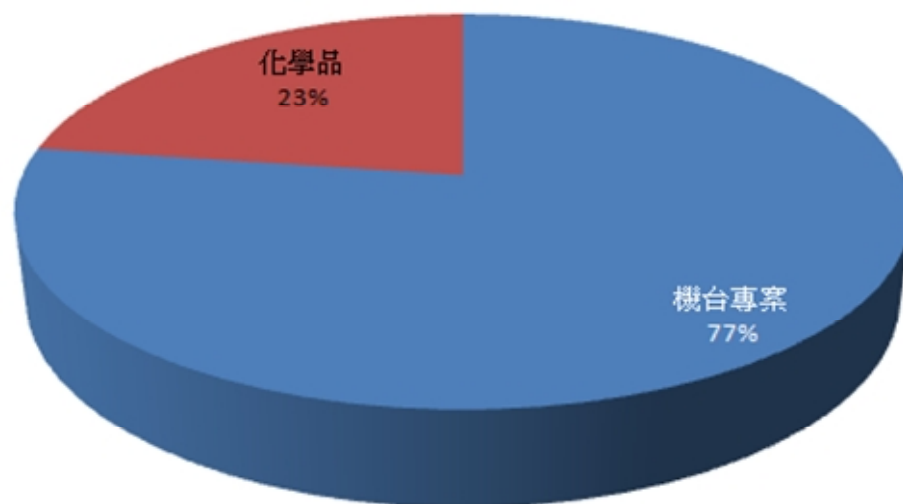
1) 營收分析

2) 接單分析

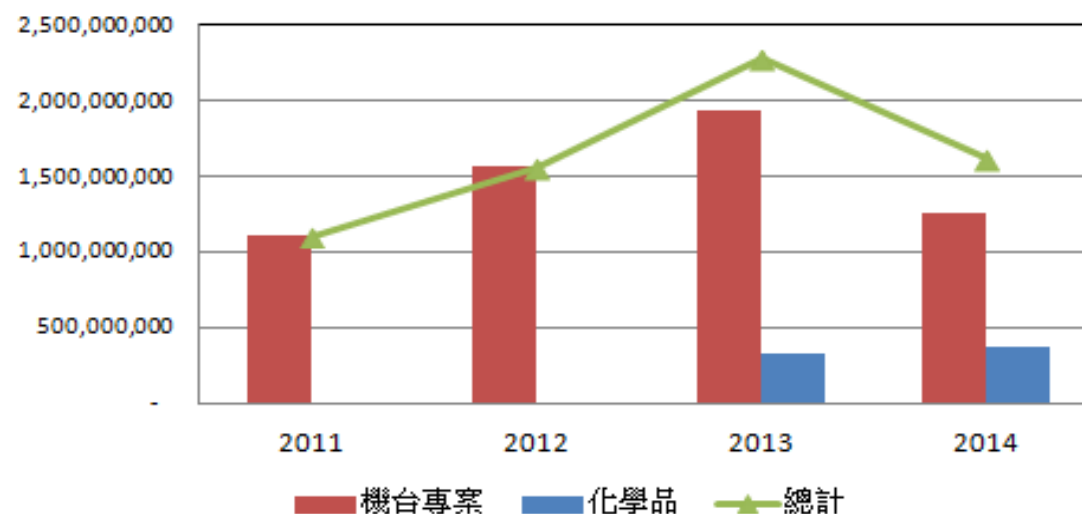
3. 成長策略

弘塑2014營收分析- 合併

營業額佔比%



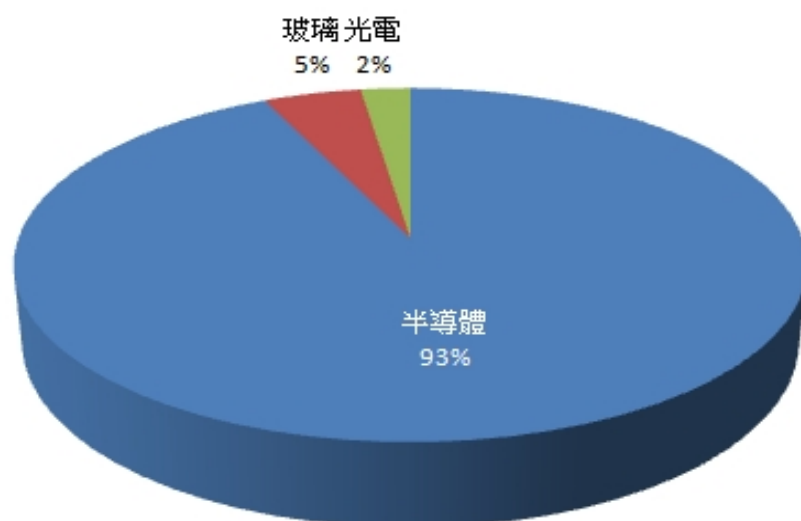
弘塑歷年營收



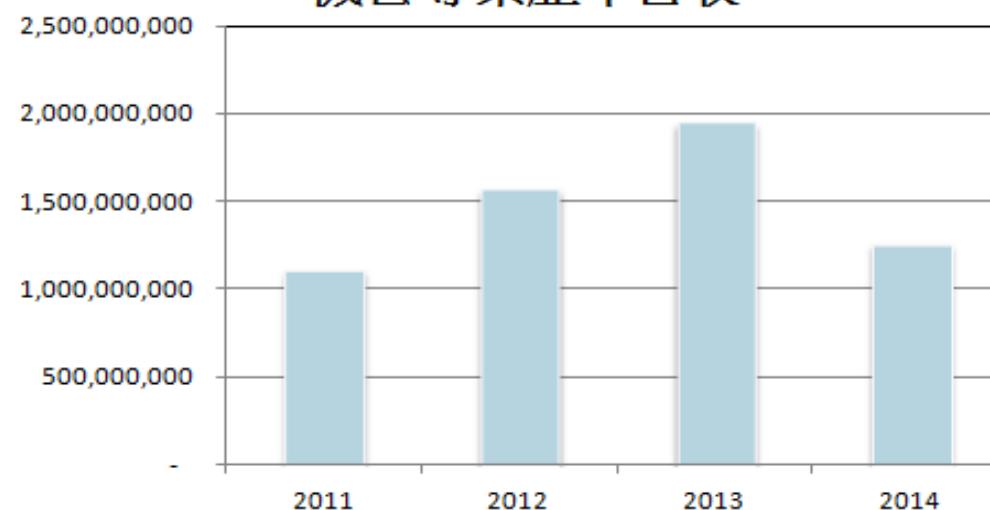
Remark:

1. 化學品營收合併計自2013年度起
2. 化學品於2013、2014利潤貢獻約為\$71,851、\$82,966(KNTD)

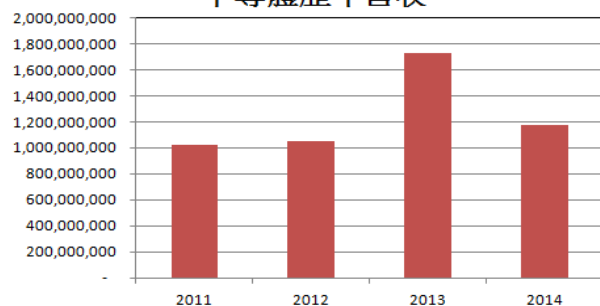
弘塑2014專案機台銷售分析—依產業應用別



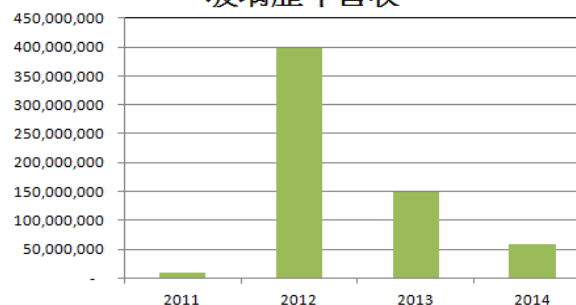
機台專案歷年營收



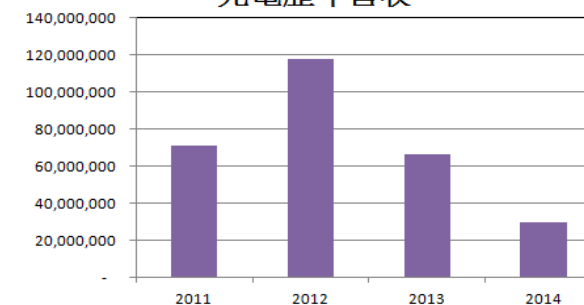
半導體歷年營收



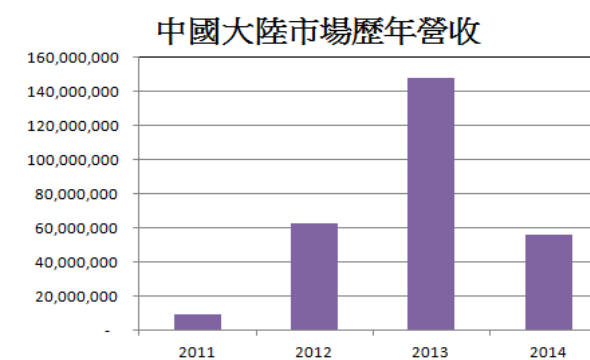
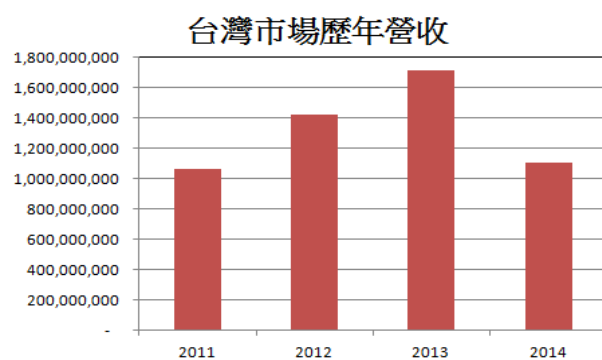
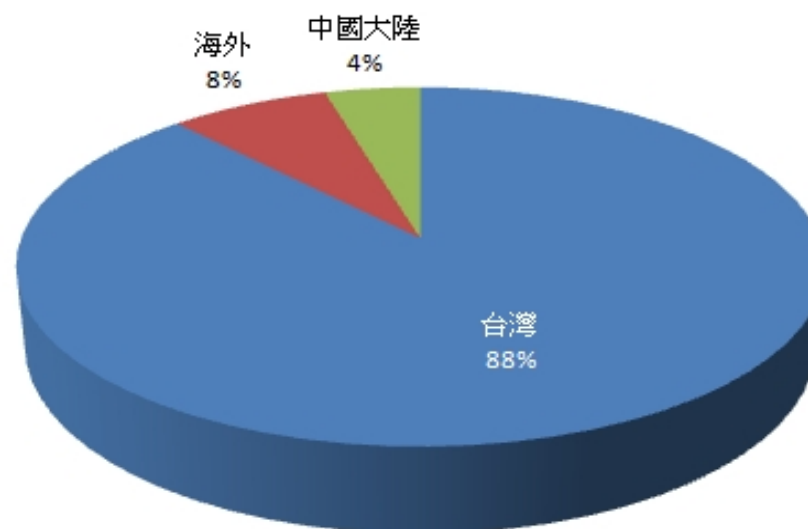
玻璃歷年營收



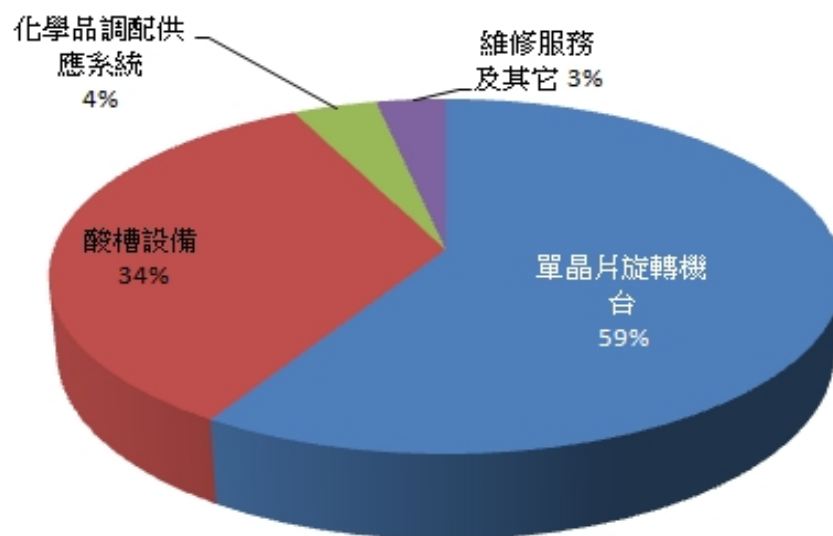
光電歷年營收



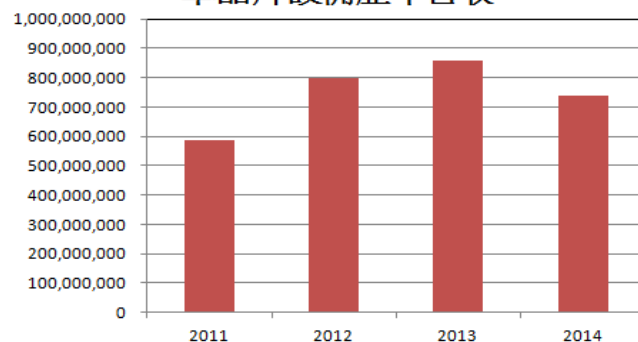
弘塑2014專案機台銷售分析—依區域別



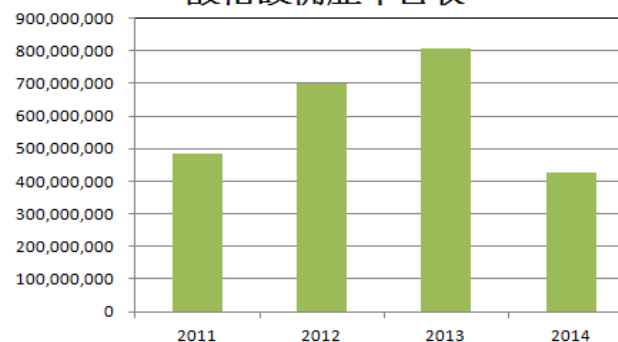
弘塑2014專案機台銷售分析—依產品分類別



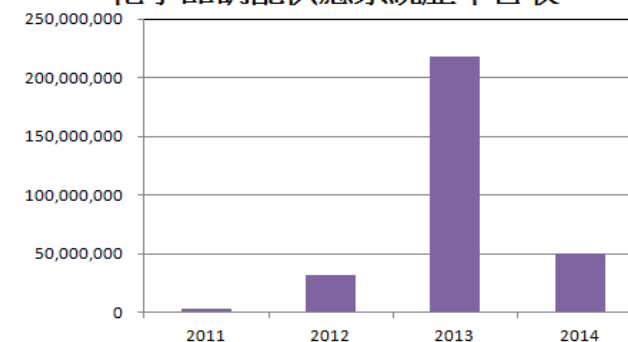
單晶片設備歷年營收



酸槽設備歷年營收



化學品調配供應系統歷年營收



Agenda

1. 市場驅動力及產業變化

2. 銷售分析

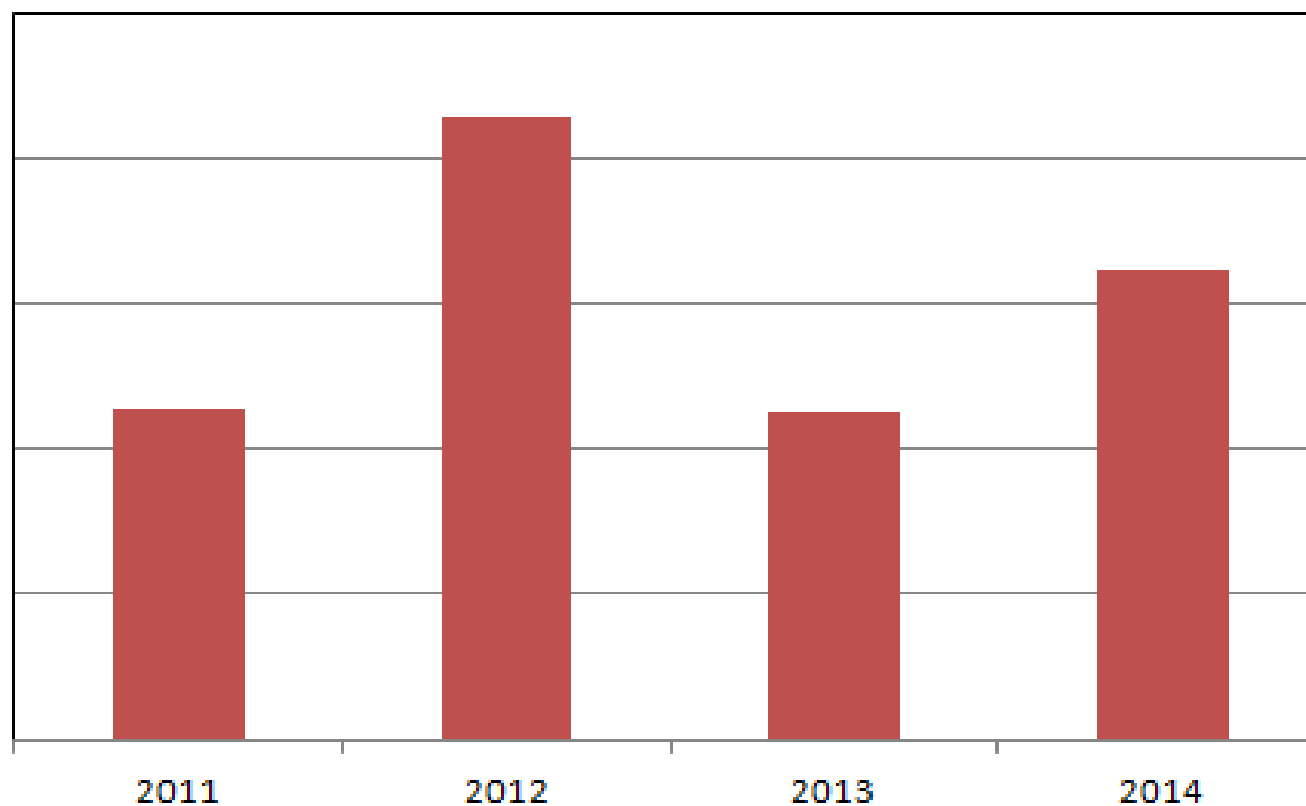
1) 營收分析

2) 接單分析

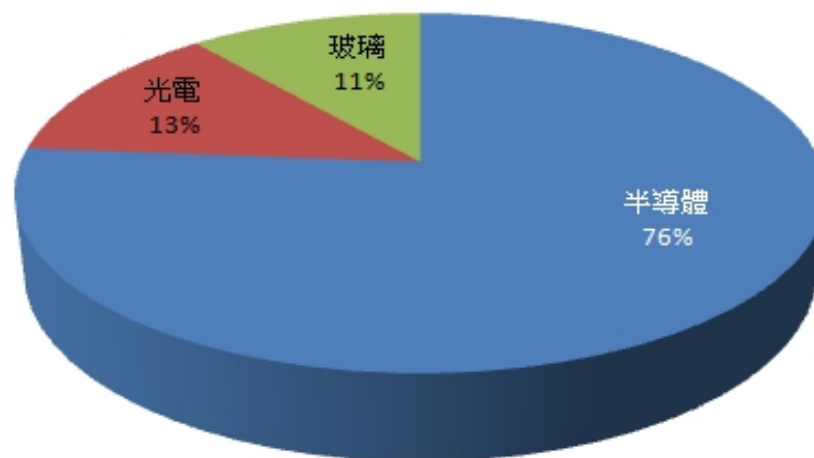
3. 成長策略

弘塑2014專案機台接單分析- 總額

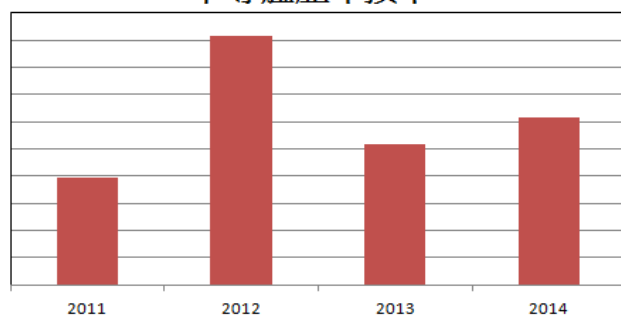
專案機台歷年接單



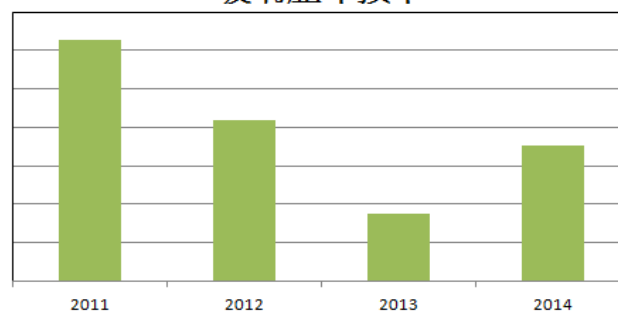
弘塑2014專案機台接單分析—依產業應用別



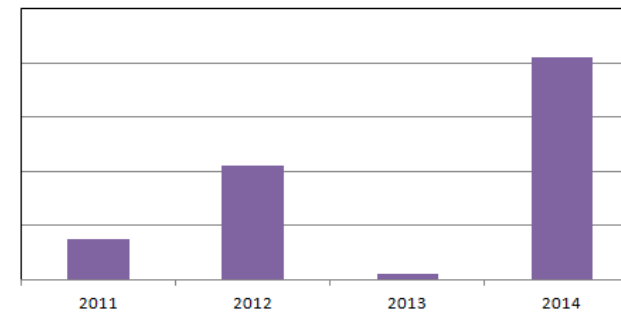
半導體歷年接單



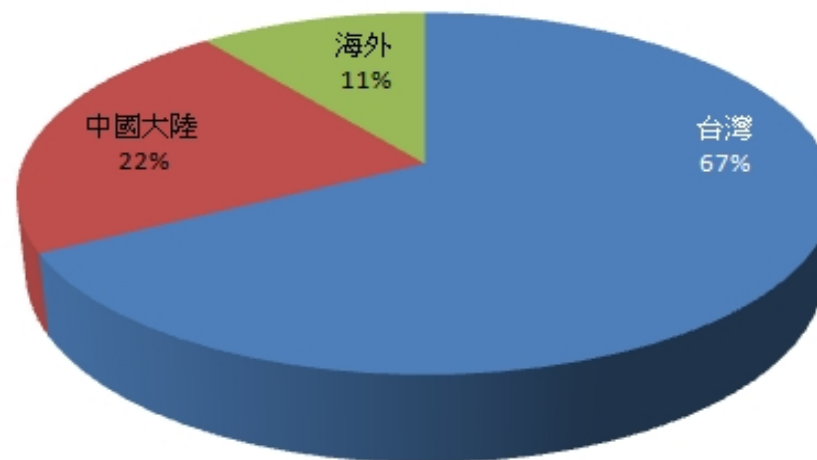
玻璃歷年接單



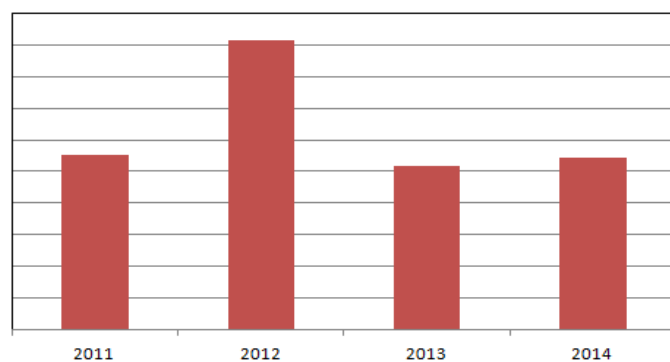
光電歷年接單



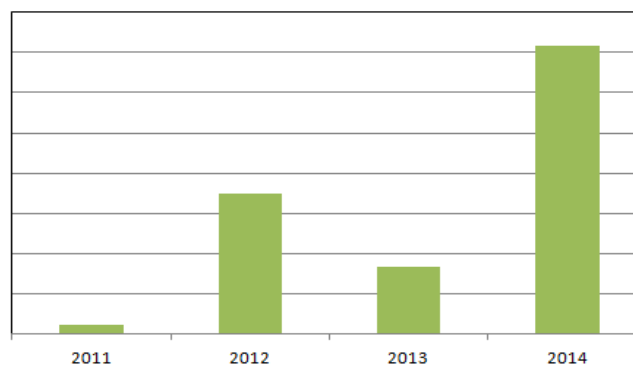
弘塑2014專案機台接單分析—依區域別



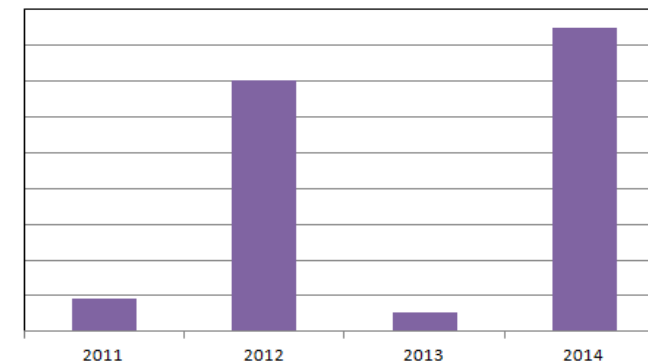
台灣市場歷年接單



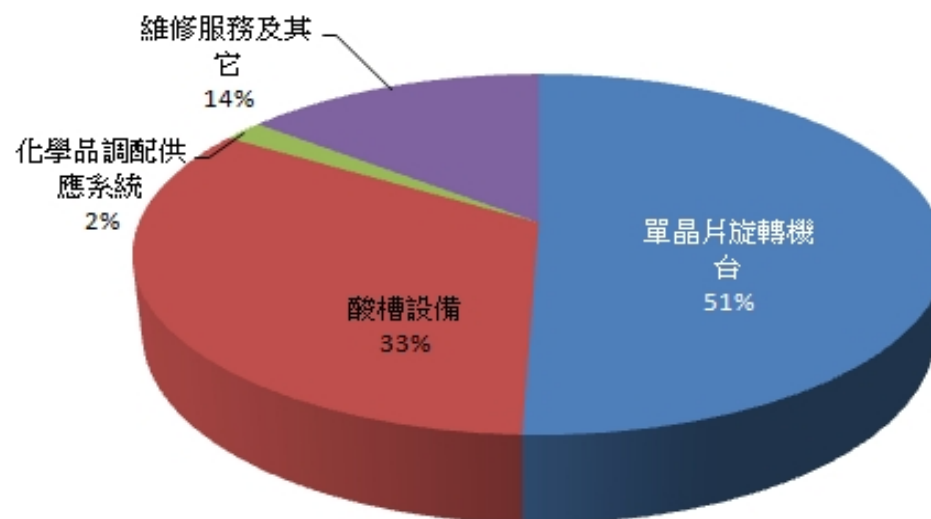
中國大陸歷年接單



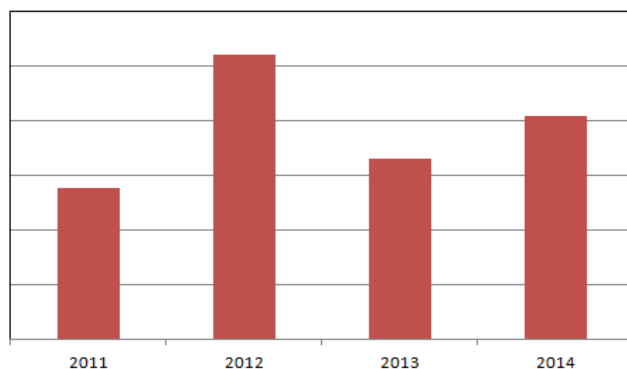
海外歷年接單



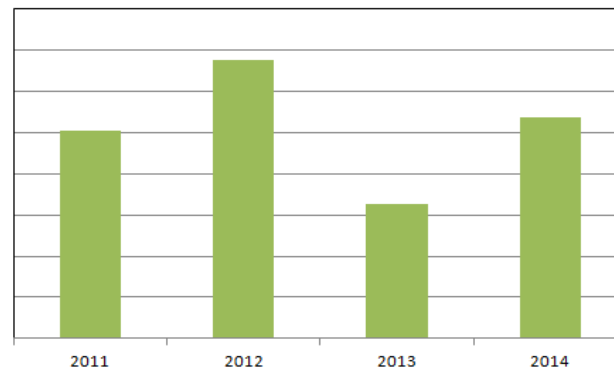
弘塑2014專案機台接單分析—依產品分類別



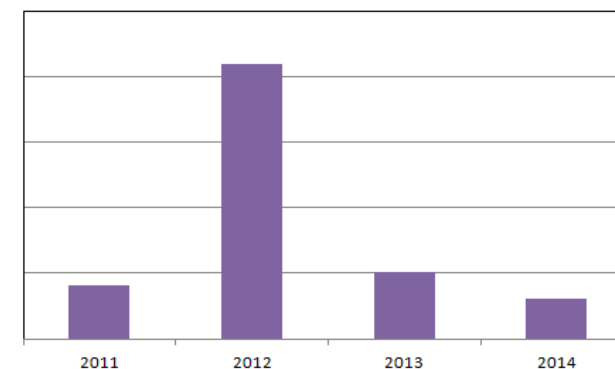
單晶片旋轉機台



酸槽設備



化學品調配供應系統



Agenda

1. 市場驅動力及產業變化
2. 銷售分析
3. 成長策略

Strong Partnership with Customers

Semi



GPTC Business Strategy

- ü Team up with customers in RD to deliver innovation of valuables
- ü Customized unique for differentiation
- ü Instant services at arm length

Panel Opto

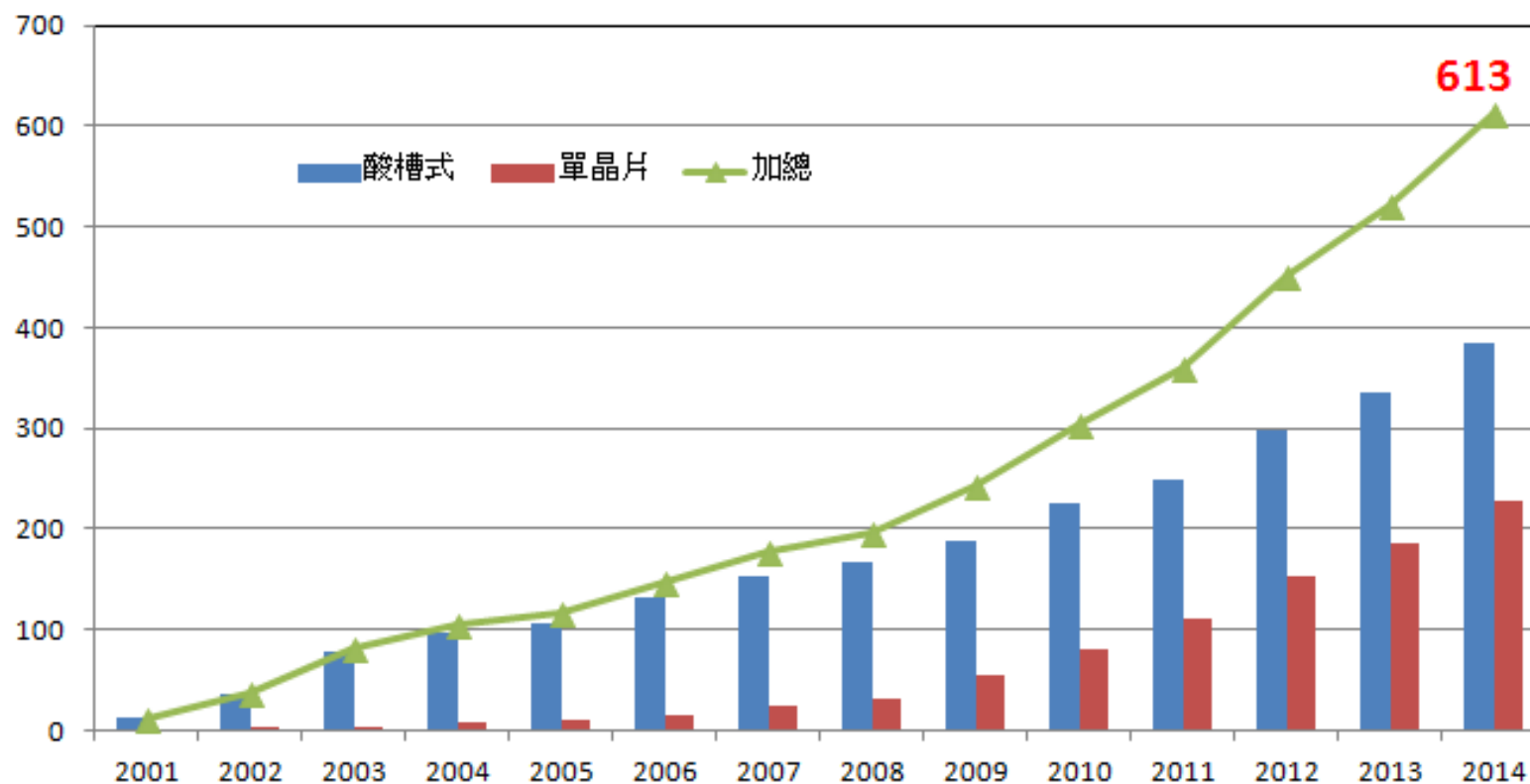


LED PSS Wafer



歷年累計安裝

歷年累計安裝機台數量



弘塑成長策略

1

- 持續招攬吸引優秀人才，提昇台灣半導體相關製程技術

2

- 佈局擴大設備機台種類及能力

3

- 與客戶經營更緊密夥伴關係

4

- 持續整合不同專業及必要的策略投資

Technology & Products Trend

Presented by Evan Wu

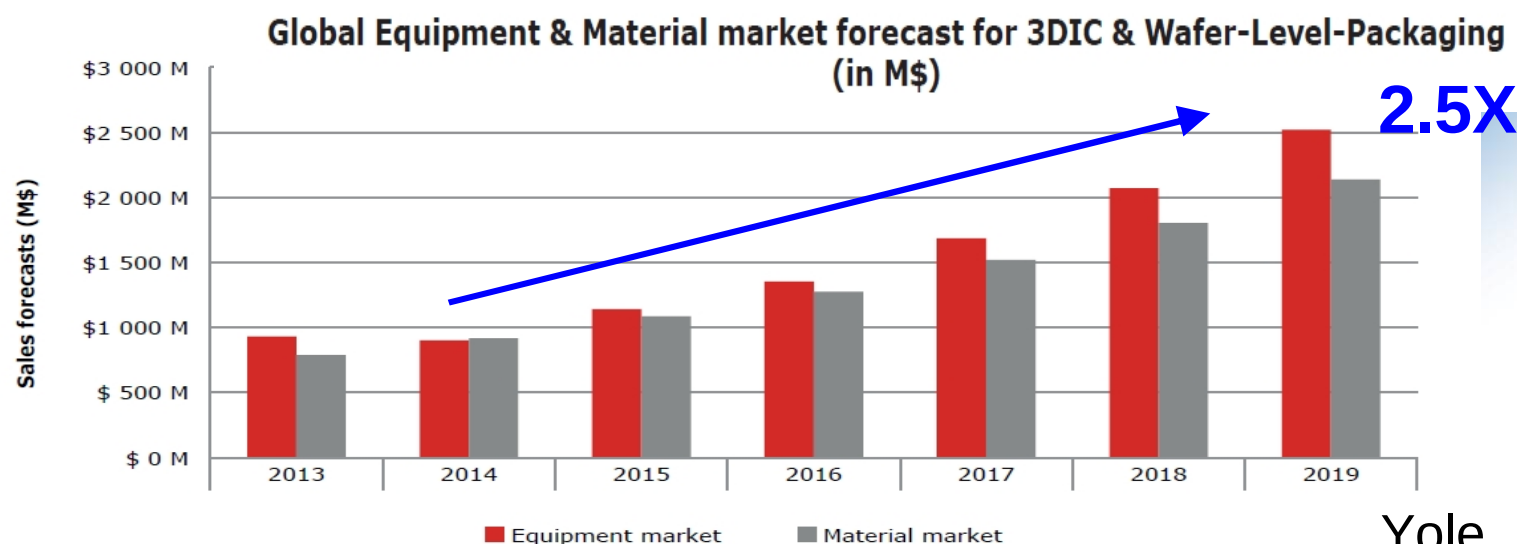
吳欣賢 產品中心 副總經理

半導體三大機會

- 2014年3月27日台積電董事長張忠謀先生說明未來半導體產業方向，預期物聯網、穿戴式裝置及智慧家庭將是下波機會，需掌握三大技術。

(1)先進封裝 (2) 感應器與微機電整合 (3) 超低耗能

- 在先進封裝技術上，將各個不同製程晶片以系統封裝(SiP System in Package)或是3DIC封裝整合一起是未來趨勢。

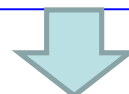


Fan-Out: Package technology, Cost driven is a trend

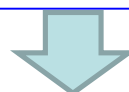
(已有成果在客戶端)

(已有成果在客戶端)

200mm FOWLP



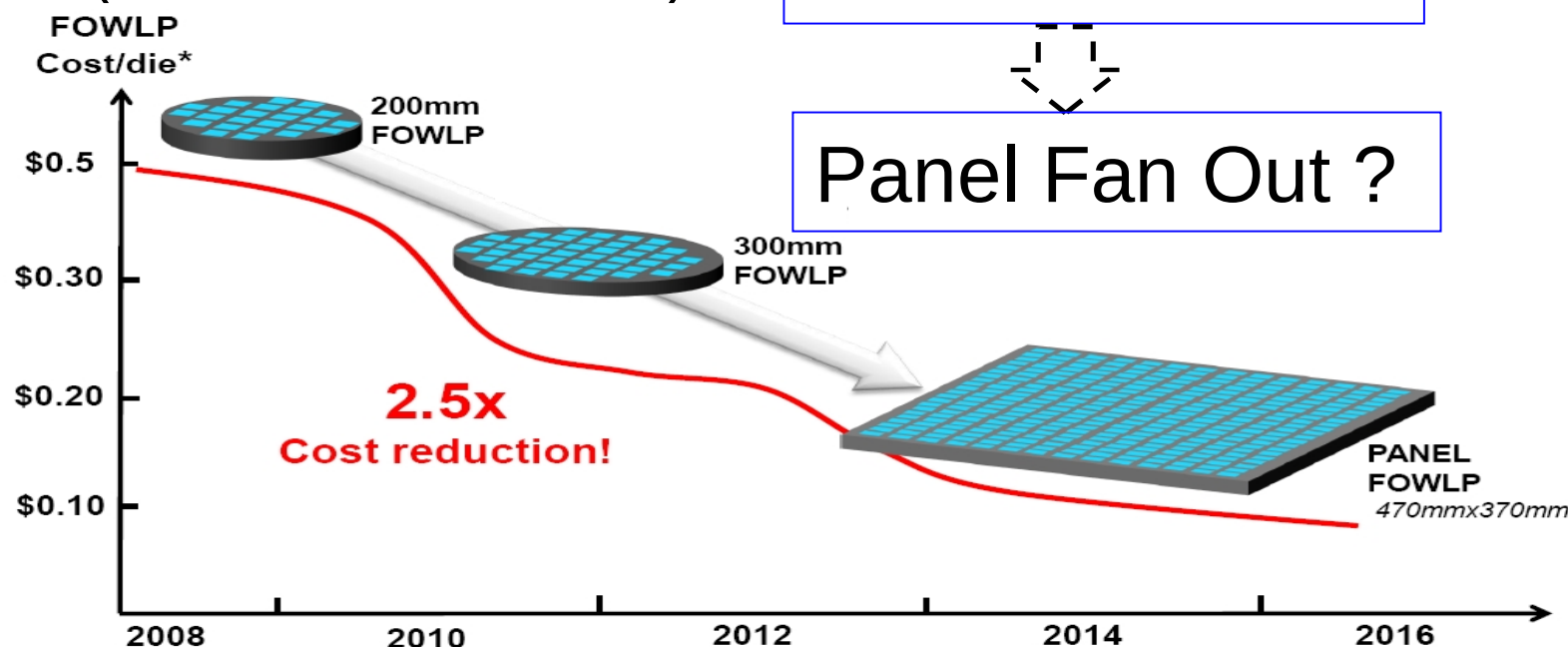
300mm FOWLP



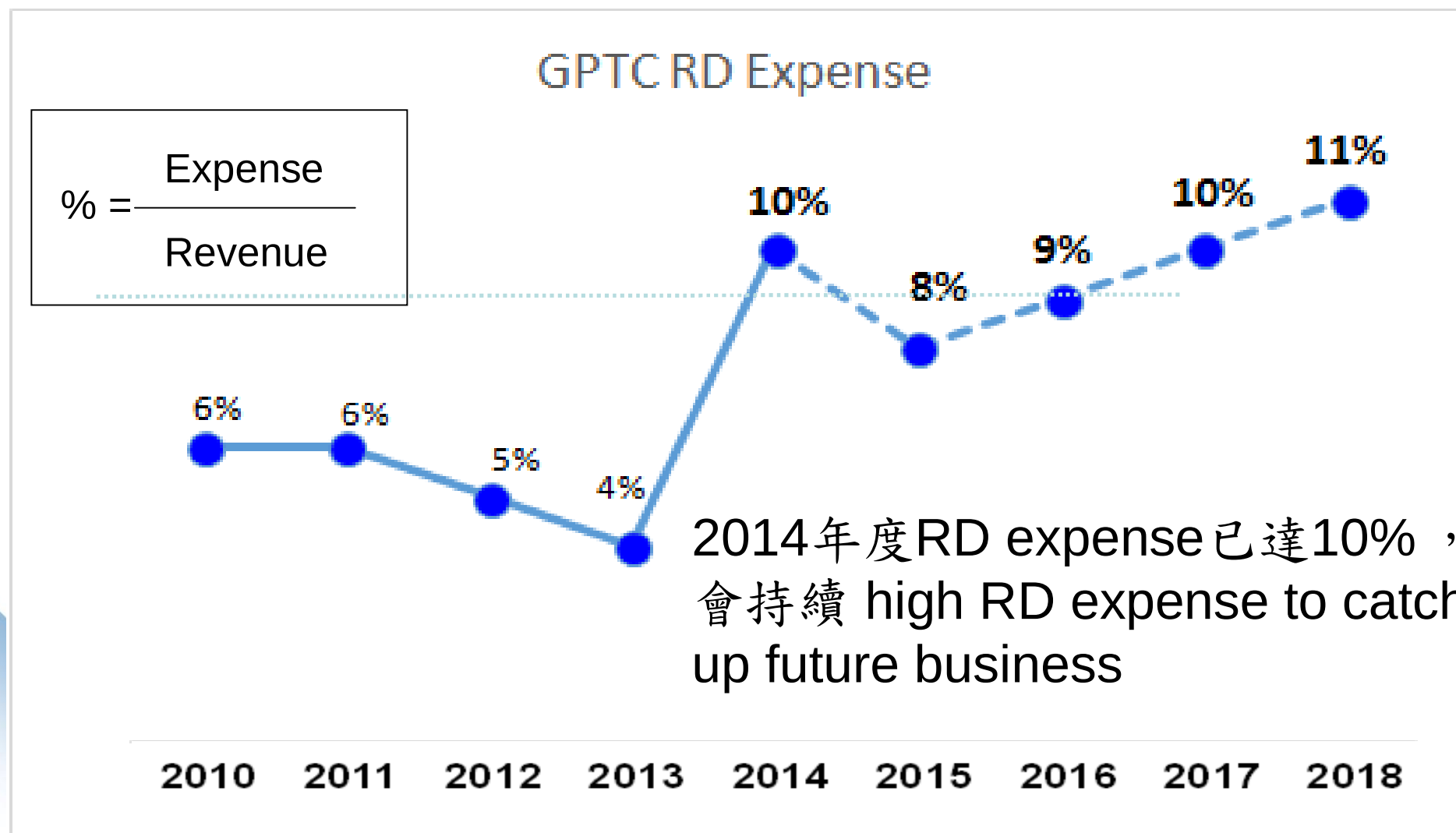
330mm FOWLP



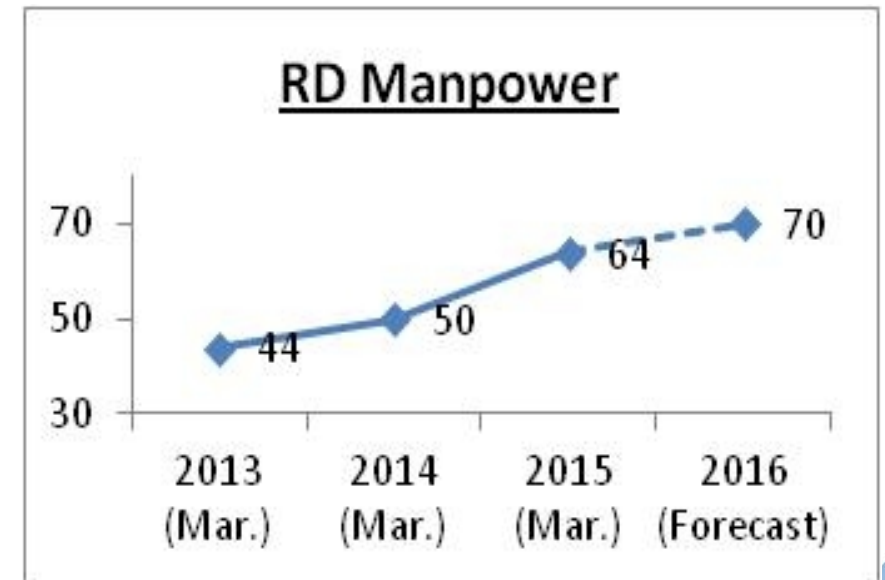
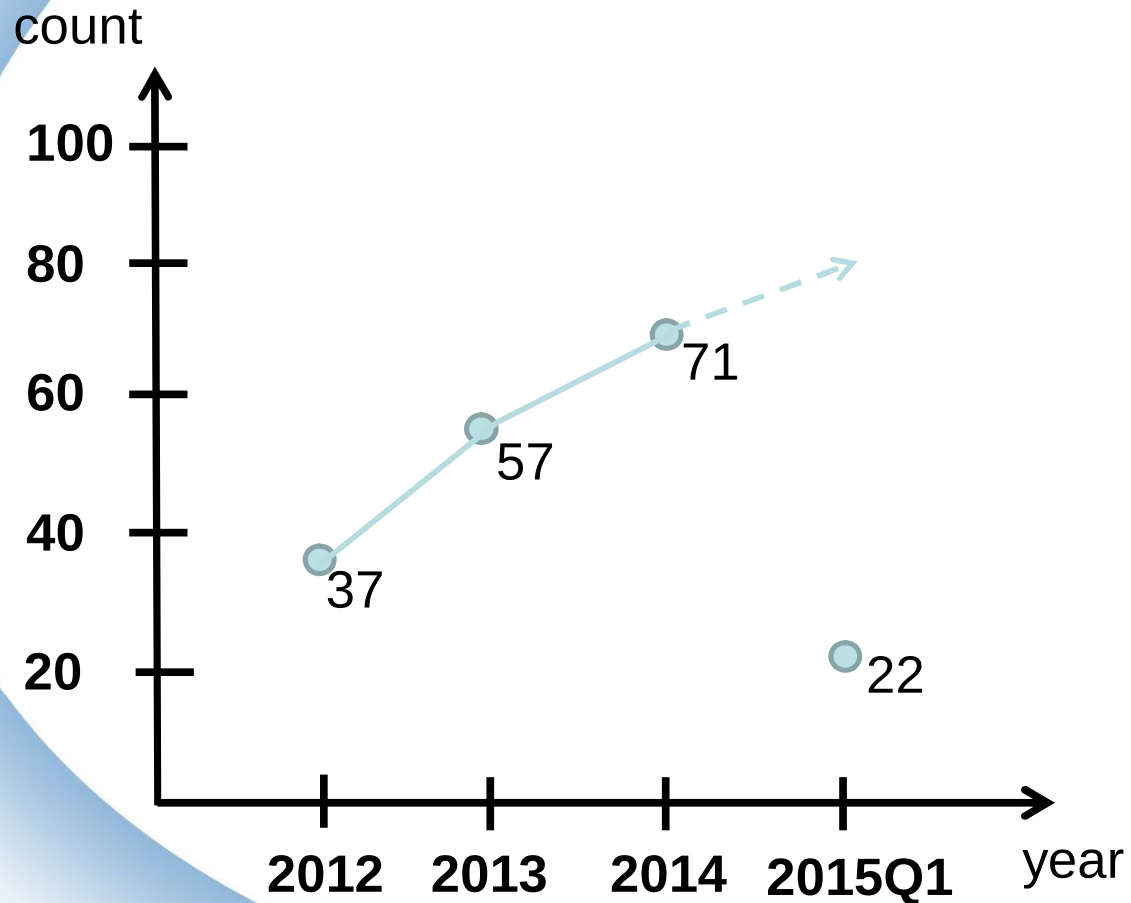
Panel Fan Out ?



因應未來封裝產業的大躍進 弘塑於RD投資趨勢

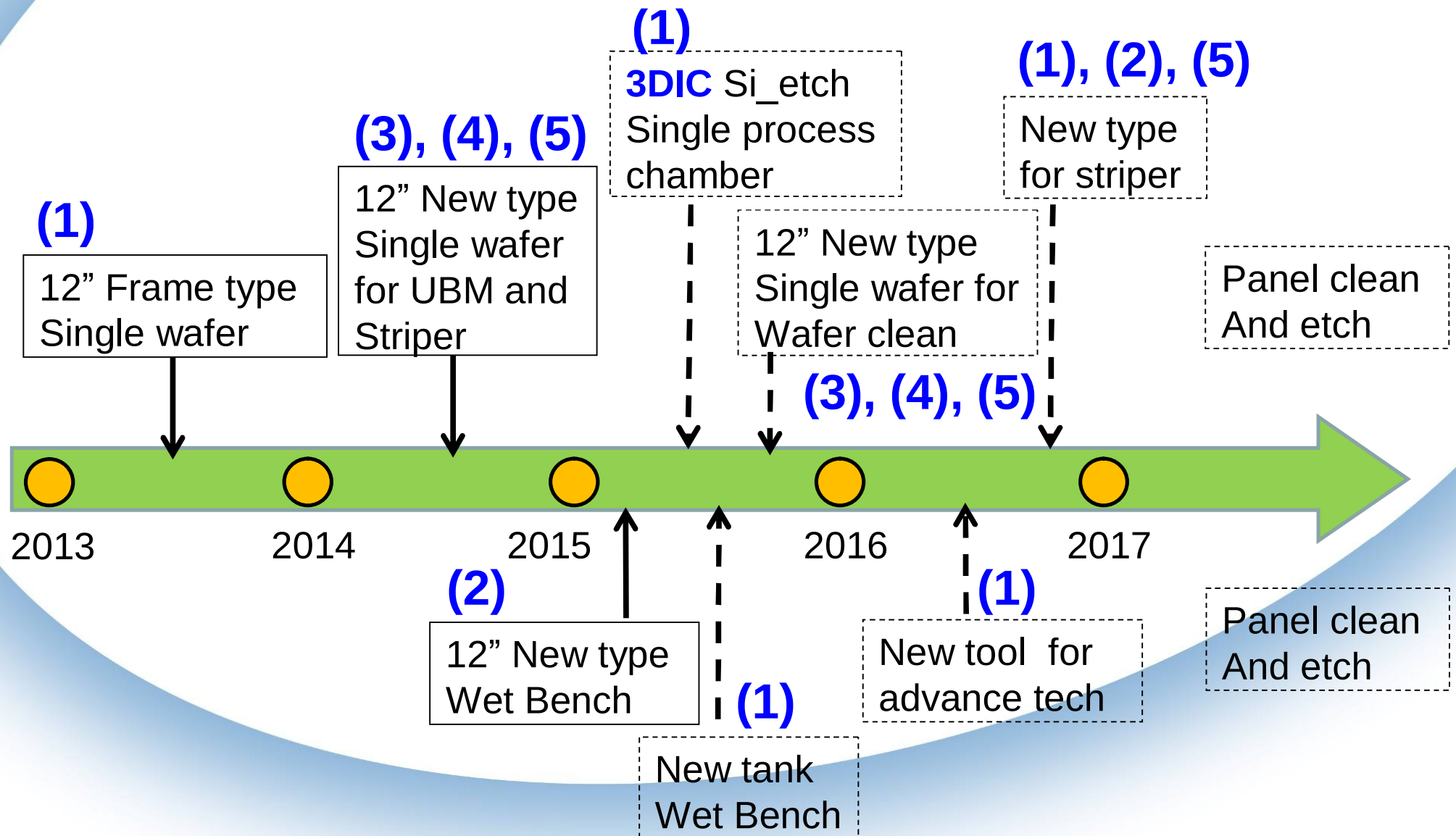


Customer Demonstration and Talent recruiting



New-hire	Ph.D & Master	Bachelor
2013	4	1
2014~2015 Apr.	7	7

客戶需求, (1) Process Functions, (2) Productivity,
(3) Footprint, (4) Lead time, (5) Cost



總結

- 持續高比例投資RD
- 持續recruiting talent
- 持續推出新機台

Thanks !

Contact Us

Mail: invest@gptc.com.tw

Telephone: +886-3-5183030 ext. 2002